



技术要求 (at25°C)

- 1.Kp: ≥ 0.58
- 2.fr: $258 \pm 10 \text{ kHz}$
- 3.C: $2850 \pm 10\% \text{ pF}$ (at 1KHz)
- 4.绝缘电阻: $100 \text{ M}\Omega \text{ min}$ (at 100VDC)
- 5.银层(阴影部分) 光亮, 无缺银, 氧化等现象, 可焊性好
- 6.银层厚度: 正面 (Ag) $0.008 \text{ mm} - 0.010 \text{ mm}$,
反面 (90%Ag+10%W) $0.004 \text{ mm} - 0.005 \text{ mm}$
- 7.银层粘接强度: $> 5 \text{ N/mm}^2$

					Ø8x0.2F1被银瓷片			PZT		
										凯普电子有限公司
标记	处数	日期	签名	更改文件号	版本号	重量	比例	KC5.001.061		
制图	设计	校对	工艺	标准化	批准	1.0				
				日期	第 页 共 页					

D

D